

SMコンタクト

SM contact

SM-Z365325-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 3.4 ~ 5.0mm Height: 3.4 mm to 5.0 mm

用 途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、
家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

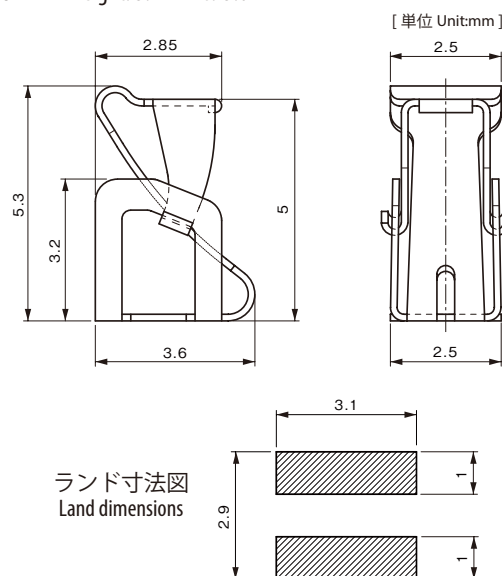
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数 量 Quantity	備 考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	30,000ヶ (外箱) 30,000/box	15リール/1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特 性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以上 5 N or more	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間：12サイクル 歪率(%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0：初期高さ t1：処理後高さ t2：スパーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec.